

โครงการวิจัยอุตสาหกรรมนี้เป็นการศึกษาถึงผลกระทบของปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เพื่อลดผลิตภัณฑ์บกพร่อง ประเภทค่าความหยาบผิวร่องลูกปืนในกระบวนการเจียรไนของแกนเพลลาใน โดยมี การศึกษาปัจจัยการผลิตสำหรับกระบวนการเจียรไน เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อค่าความหยาบ ร่องลูกปืน ทำให้ปริมาณผลิตภัณฑ์บกพร่องลดลง ในงานวิจัยนี้ได้ใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง แบบ 2^6 แฟคทอเรียลและเทคนิคการวิเคราะห์แบบ ANOVA มาประยุกต์การปฏิบัติทดสอบและการ วิเคราะห์เพื่อหาระดับปัจจัยในการผลิตที่เหมาะสม จากการทดลองพบว่าค่าปัจจัยที่เหมาะสมมี ดังต่อไปนี้ คือ (1) จำนวนครั้งในการสั่นหินเจียรไนขณะการขัดหยาบ 800 cpm (2) จำนวนครั้งใน การสั่นหินเจียรไนขณะจบ 90 cpm (3) ความเร็วรอบของชิ้นงานในขณะการขัดหยาบ 1,600 รอบต่อ นาที (4) ความเร็วรอบของชิ้นงานในขณะจบ 2,800 รอบต่อนาที (5) แรงกดของหินเจียรไนขณะขัด หยาบ 0.5 MPA และ (6) แรงกดของหินเจียรไนขณะจบ 0.5 MPA ดังนั้นสัดส่วนผลิตภัณฑ์บกพร่อง ในกระบวนการเจียรไนแกนเพลลาในลดลงจากร้อยละ 0.19 เป็นร้อยละ 0.006 มีค่าความหยาบผิวร่อง ลูกปืนของชิ้นส่วนแกนเพลลาใน (Rz) โดยเฉลี่ยลดลงจาก $0.3734 \mu m$ เป็น $0.2806 \mu m$ และ ความสามารถของกระบวนการเจียรไน (Cpk) เพิ่มขึ้นจาก 0.55 เป็น 3.11

This industrial project is to study the effect of production factor for reduce raceway roughness defectives of Inner Shaft in a grinding process. By study production factor for grinding process and find a proper factor impact to raceway roughness .Therefore, amount of defect can reduce down clearly that this industrial project applied 2^6 factorial design of experiment techniques and ANOVA analysis techniques are applied in this operation and analysis for the level of production factor proper value. From the result of experiment can find proper factor data as follow are (1) Oscillation rough 800 cpm, (2) Oscillation finish 90 cpm, (3) Work spindle rough 1,600 rpm, (4) Work spindle finish 2,800 rpm, (5) Pressure rough 0.5 MPA, and (6) Pressure finish 0.5 MPA .Therefore, ratio of defects in Inner Shaft grinding process can decrease from 0.19 percent to 0.006 percent, the Raceway roughness of Inner Shaft (Rz) by average can decrease from $0.3734 \mu m$ to $0.2806 \mu m$ and the process capability of grinding process (Cpk) can increase from 0.55 to 3.11 .